

RESHAPE, RESTYLE, REINVENT

IMSE™技術とは筐体・電子部品・配線を一体化する革新的な技術で、多くの欧米大手自動車関連企業に採用されています。

電子機器の軽量化・薄型化・耐久性・デザイン性の向上に寄与します。



メリット



最大80%軽量化



組立工程の省力化



最大90%薄型化



タッチセンサ感度UP



デザイン自由度UP



アンテナ性能UP



デザイン変更が容易



耐久性と信頼性UP

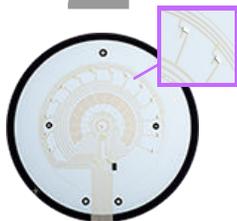
プロセス

1



タッチセンサや
アンテナ回路をプリント

2



フィルム上に
LED等の部品を搭載

3



熱成形で
3D形状に加工

4



射出成形

使用可能材料



- 金型ラベリングフィルム : 標準で0.175 mm - 0.375 mm
装飾用IMLフィルム : 本木 (ほんもく)、クロム、他
コーティング : スプレー、プリント、UV (フィルム強化)
装飾用インク : カラー、パール、ラッカー、特殊効果インク
導電性インク : 回路、ワイヤーハーネス、アンテナ、
静電容量センサ
誘電体 : 材料に依存
接着剤 : 電子部品用
射出成形用樹脂 : ポリカーボネート (PC)、アクリル樹脂 (PMMA)、
熱可塑性ポリウレタン (TPU)、ABC、他

アプリケーション

ドアトリム



灰皿カバー



オーバーヘッド コントロールパネル



静電容量センサやLEDをインサート成形

etc.

国内代理店

コーンズテクノロジー株式会社

CORNES
Technologies

電子通信ソリューション営業部

〒105-0014 東京都港区芝3-5-1 コーンズハウス

Tel. 03-5427-7566 Fax. 03-5427-7572

<https://www.cornestech.co.jp/tech/>

WWW.TACTOTEK.COM